

O-leading PCB 3D 印刷

O-Leading PCB 印刷, PCB 印刷 PCB 印刷 (PCBA) 印刷 EMS 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 HDI PCB, 印刷 PCB, 印刷-印刷 PCB 印刷 印刷 PCB 印刷 印刷. 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷.

印刷 印刷 印刷 印刷, 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷. 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 O 印刷 印刷.

印刷 O-leading 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷, 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 PCB 印刷 PCBA 印刷 印刷 印刷 印刷.

印刷 印刷 印刷 印刷. [印刷-印刷 印刷 PCB 印刷](#)

印刷 印刷

H0BR4x STM32F0 MCU, LSM6DS3 IMU 印刷 LSM303AGR 印刷 印刷 印刷 3 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 3 印刷 印刷 印刷 (IMU)印刷.

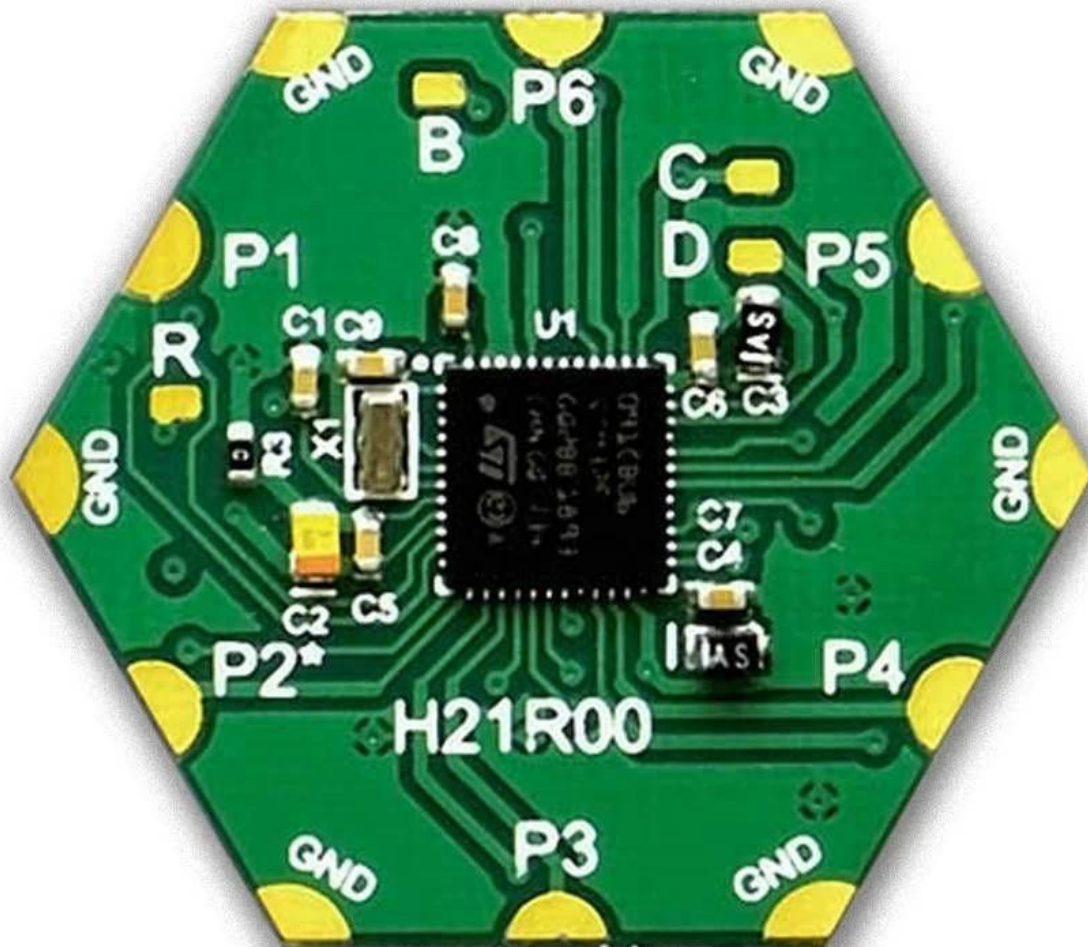
印刷 印刷 印刷 印刷 2 x 3 印刷.

* 印刷 印刷 3 印刷.

* 印刷 印刷 印刷 印刷 3 印刷.

* 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷.

* 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 印刷 H0BR4x 印刷 IMU 印刷.



□□ □ □□ □□ :

- * □□ / □□□ □□ □□ □□□□□□.
- * □□ □□□ □□ □□□ □□ SRAM □□, CLI □□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- * □□ □□□□ □□ SRAM □□, CLI □□ □□ □□ □□□ □□□□ □ □ □□□□. □□□□ □□ □ □□ (□□□□ □□□) □□□ □ □□□□.
- * □□ □□□□□ □□□□□ □□ Hexabitz □□□ □□□□□□□!

□□ □□
□□□ □□

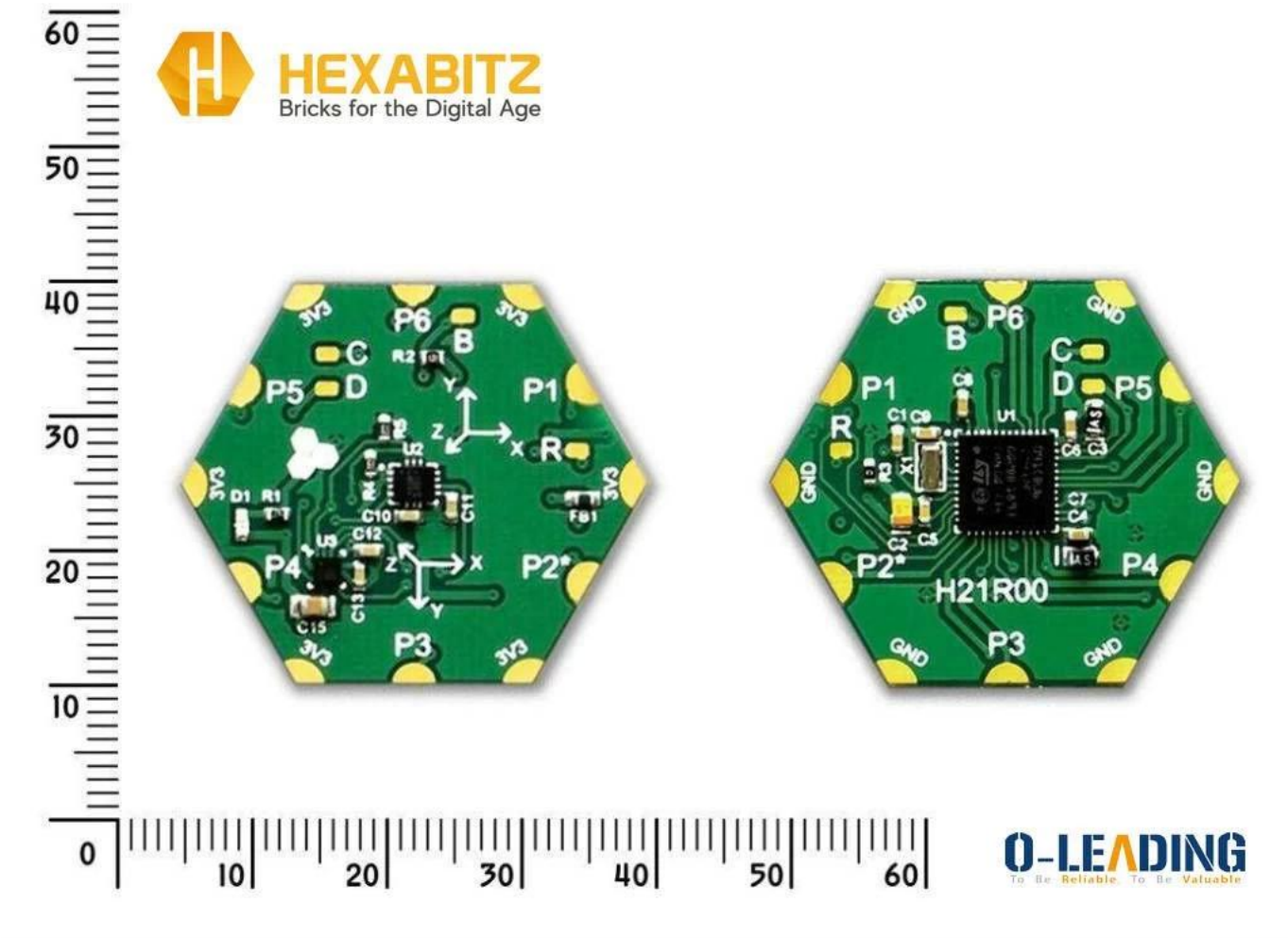
- * ST LSM6DS3 iNEMO □□ □□ (3D □□□□ □ 3D □□□ □□□) :
- * $\pm 2 / \pm 4 / \pm 8 / \pm 16g$ □□□□ □ □□□.
- * $\pm 125 / \pm 250 / \pm 500 / \pm 1000 / \pm 2000$ dps □□□ □□□ □ □□□.
- * □□ 6kHz ODR.
- * □□ □□ □□.

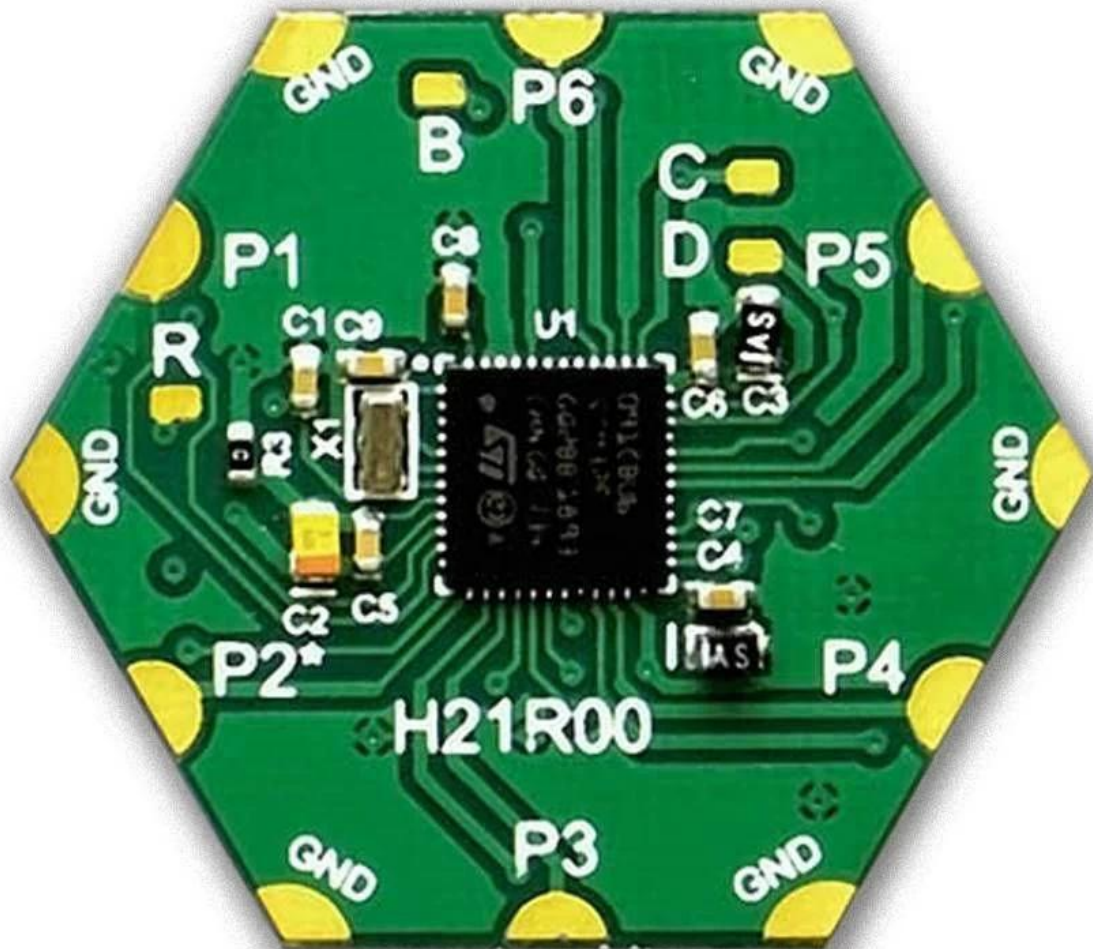
- * ST LSM303AGR eCompass □□ (3D □□□□ □ 3D □□□) :

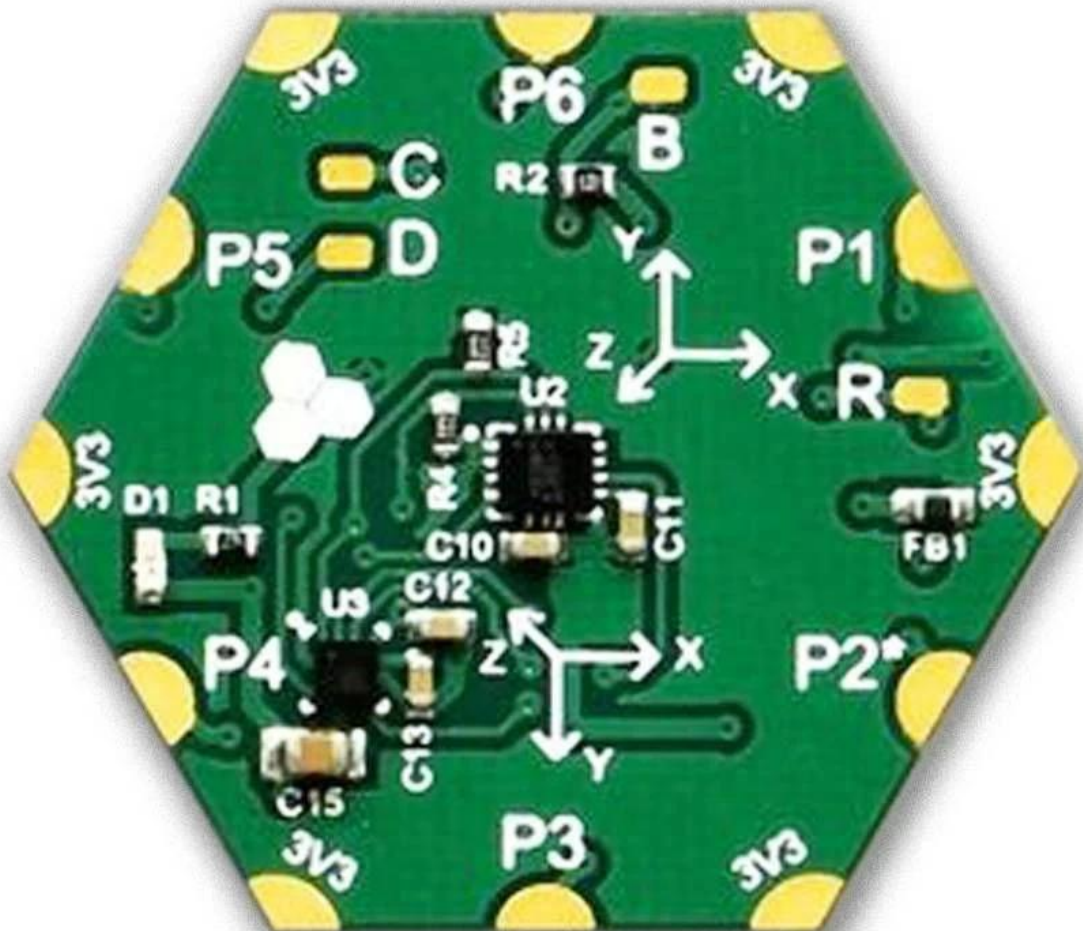
- * ± 50 重量 約 50g.
- * ± 2 / ± 4 / ± 8 / ± 16g 重量 約 10g.
- * 約 150Hz ODR.

- 機能
 - * STM32F091CBU6 32 ビット ARM Cortex-M0 MCU.
 - * 8MHz 約 100k.
 - * 6 軸 加速度 計 6 軸 角速度 計 (+ 3.3V 約 GND).
 - * 6xUART, 2xI2C, SWD, BOOT0, RESET 約 10pin.

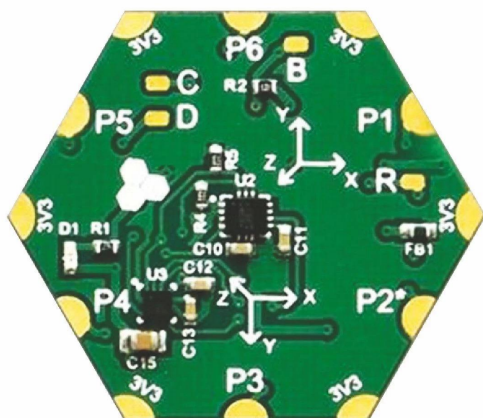
仕様 項目	
形状:	六角形
寸法:	約 30mm, 約 17.32mm
厚さ:	7.8mm 約 2
材質:	FR-4
表面処理:	約 100
表面処理:	ENIG (約) 約 HASL-LF (約)







HEXABITZ QUICK START GUIDE



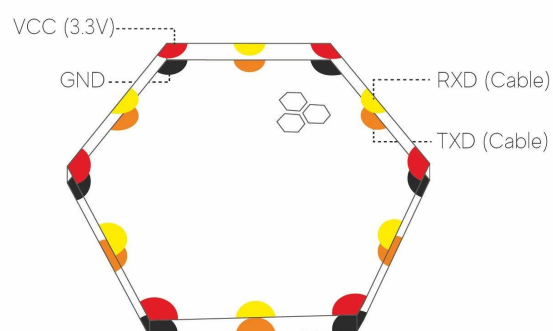
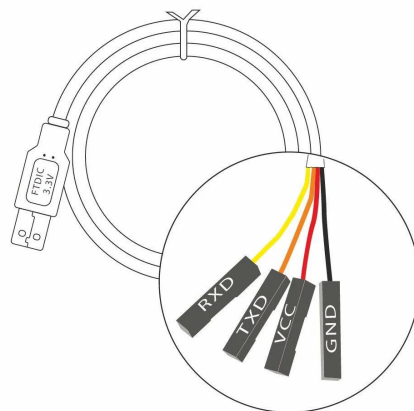
HOB4x

IMU & Digital Compass

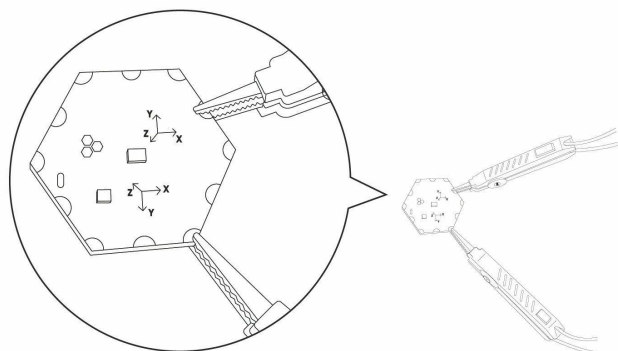
link



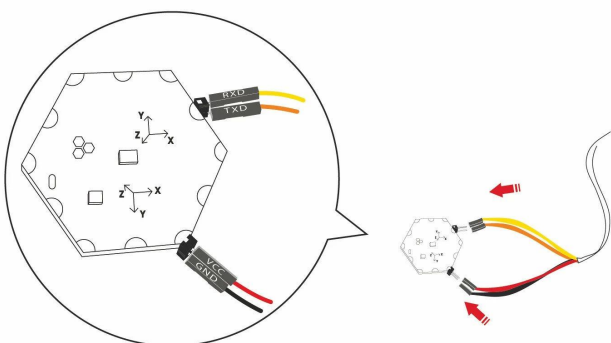
Re-48-19



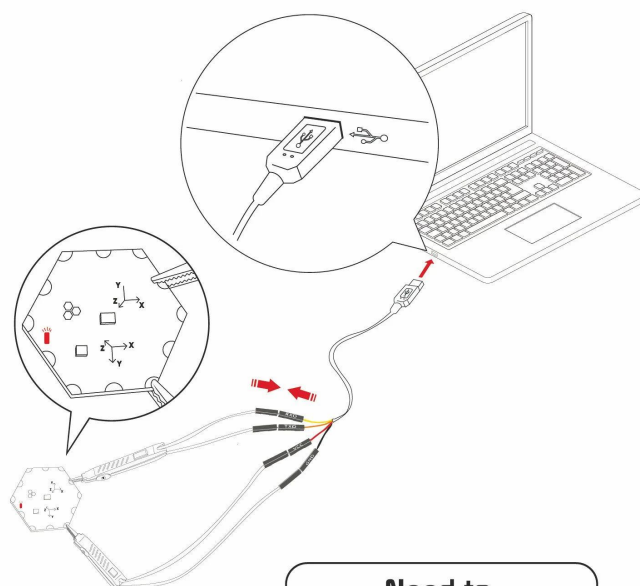
1



OR



2



**Need to
update firmware?**



link

3



RealTerm
[Windows]



Putty
[Windows/Mac/Linux]



SecureCRT
[Windows/Mac/Linux]

Use your favorite terminal software with these settings:

- o Baudrate: 921600
- o Display Format: Ansi
- o Parity: none
- o Data Bits: 8
- o Stop Bit: 1
- o Hardware Flow Control: none

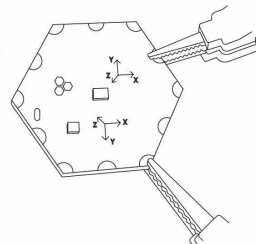
Open the virtual COM port and hit the ENTER key.
Module will respond with a welcome message.

4

Try some CLI commands:

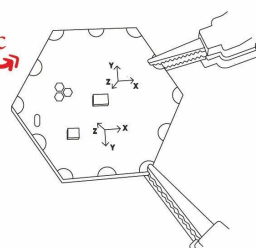
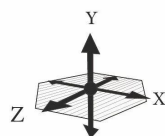
```
>> sample temp
```

Temp (Celsius) | 25.23



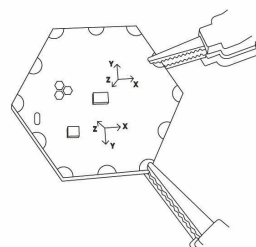
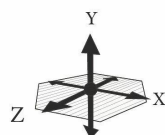
```
>> sample gyro
```

Gyro (DPS) | X: 3.27, Y: 1.12, Z: -0.71



```
>> sample acc
```

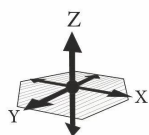
Acc (G) | X: 0.17, Y: 0.23, Z: -0.92



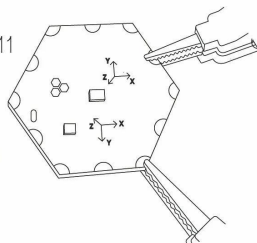
5

```
>> sample mag
```

Mag (mGauss) | X: 12.01, Y: 36.22, Z: 29.11



mGauss

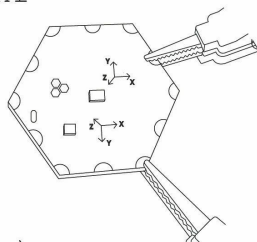


```
>> stream temp 500 inf
```

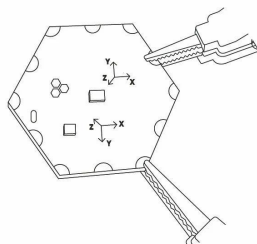
Temp (Celsius) | 25.23

Temp (Celsius) | 25.23

Temp (Celsius) | 25.23



```
>> stop (or ENTER key)
```



6

Type `>> help` for more CLI commands.

Check module documentation, schematics, firmware and design files in the Resources tab.



Resources



Related Projects

7



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT







ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max					
	Min	Min			Area	Solder	Oper	Flame	Meets	C	
	mm(in)	Edge mm(in)			Diam	Limits	Temp	Class	UL796	T	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.“经 UL 允许从在线认证目录转载”声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

PCB 規格

PCB 材料	
銅箔厚度	1 1/2-32 吋
銅箔重量	1 / 3oz-12oz
銅箔厚度 / 銅箔重量	3.0mil / 3.0mil
銅箔厚度 / 銅箔重量	4.0mil / 4.0mil
銅箔厚度	10 : 1
銅箔厚度	0.2mm-5.0mm
銅箔厚度 (mm)	635 * 1500mm
銅箔厚度 (mm)	4mil
Plated 銅箔	+/- 3mil
Blind / Buried Vias (All 銅箔)	否
銅箔 (銅箔, 銅箔)	否
銅箔	FR-4, FR-4high Tg. 銅箔 銅箔, 銅箔, 銅箔銅箔, 銅箔 銅箔, 銅箔
銅箔	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, 銅箔, 銅箔 銅箔, 銅箔 銅箔

SMT 規格	
PCB 材料	FR-4, CEM-1, CEM-3, 銅箔 銅箔 銅箔
銅箔 PCB 材料	510x460mm
銅箔 PCB 材料	50x50mm
PCB 材料	0.5mm-4.5mm
銅箔 銅箔	0.5-4mm
銅箔 銅箔 銅箔	0201
銅箔 銅箔 銅箔 銅箔	0603 銅箔
銅箔 銅箔 銅箔	15mm
銅箔 銅箔 銅箔	0.3mm
銅箔 BGA 銅箔	0.4mm
銅箔 銅箔	+/- 0.03mm

PCB 規格

Shipping service



□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□, SI6000 soft □ POLAR INSTRUMENTS□ CITS 500s □□□□ □□□□□□.
□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□.